

院所系組	電機與資訊學院 電腦與通訊工程系及半導體工程系 碩士在職專班 聯合招生	
招生分組	電腦與通訊工程系	半導體工程系
招生名額	16 名	33 名
研究領域	5G 行動通訊網路、車載資通訊、微波通訊、數位晶片設計、智慧辨識、深度學習圖像識別、數位語音處理、生醫訊號處理、機器學習、人工智慧、巨量資料分析、雲端運算、資訊安全、區塊鏈技術	半導體磊晶技術、半導體光電元件、奈米生醫感測元件、半導體製程技術、金氧半元件製程與分析、化合物半導體、奈米金屬氧化物合成、太陽能電池、半導體材料電性光性化性量測與分析、光電材料與元件製造技術、半導體元件模擬、半導體元件物理、真空鍍膜技術、薄膜工程、感測器元件、高功率脈衝濺鍍技術、光檢測器、薄膜電池、混合訊號積體電路設計、電源管理積體電路設計、射頻電子電路、毫米波積體電路、微機電元件設計、電能轉換電路設計、次世代通訊、船舶通訊系統、微處理機/嵌入式系統
甄試項目	書面資料 審查 (40%)	<ol style="list-style-type: none"> 1.基本資料表【附表 5】。 2.自傳或專業心得報告【附表 6】：請以 A4 紙張打字或書寫。 3.研究計畫或讀書計畫【附表 7】：請以 A4 紙張橫式打字或書寫。 4.大專校院歷年成績單及學業成績名次排名證明（成績單須加蓋學校章戳）、學歷（力）證件影本。 5.專業表現及學習潛能與相關特殊表現證明文件：如工作經驗、職務、參與產官學研究計畫、職業證照、專業工作成就、獲獎紀錄、創作、著作、論文發表、推廣教育學習證明及其他足資證明相關潛能之資料。 6.非單一著作、成果、競賽、獲獎貢獻百分比證明。 7.其他有助審查之文件，如推薦函等。 <p>【線上推薦函注意事項(含操作步驟)請詳簡章第 5-6 頁】</p>
	面試 (60%)	<ol style="list-style-type: none"> 1.114 年 3 月 15 日(星期六)於楠梓校區辦理面試，時程及地點另行公告。 2.符合報考資格考生均可參加面試。
成績計算	<ol style="list-style-type: none"> 1.總成績=書面資料審查成績×40%+面試成績×60% 2.各甄試項目成績及總成績均四捨五入取至小數點第二位，滿分為 100 分。 	
同分參酌順序	<ol style="list-style-type: none"> 1.面試分數。 2.書面資料審查分數。 	
特殊報考資格	本系不招收「入學大學同等學力認定標準」第 7 條「專業領域表現具卓越成就者」。	
備註	<ol style="list-style-type: none"> 1.工作年資之規定：需有 1 年(含)以上工作年資。 2.上課地點：電腦與通訊工程系於第一校區上課、半導體工程系於楠梓校區上課。 3.上課時間：週一至週五夜間。 4.113 學年度最低畢業學分數：電腦與通訊工程系 33 學分、半導體工程系 30 學分，114 學年度依各系所規定辦理。 5.聯合招生相關說明請詳閱簡章第 13、19 頁。 	
系所聯絡方式	聯絡人：楊小姐 電話：07-6011000 轉 32004	聯絡人：劉小姐 電話：07-3617141 轉 23352